

Errata

CC2755P20 SimpleLink 无线 MCU 勘误表



摘要

本文档介绍了 CC2755P20 SimpleLink™ 器件功能规格的已知例外情况（公告）。

本文档支持以下器件：

- CC2755P207E0WRHAR

内容

1 公告汇总表.....	2
2 命名规则、封装编号法和修订版本标识.....	3
2.1 器件和开发支持 - 工具命名规则.....	3
2.2 支持的器件.....	3
2.3 封装编号法和修订版本标识.....	3
3 公告.....	4

商标

SimpleLink™ and 德州仪器 (TI)™ are trademarks of Texas Instruments.
所有商标均为其各自所有者的财产。

1 公告汇总表

表 1-1 列出了所有公告、受影响的模块以及适用的器件修订版本。

表 1-1. 公告汇总表

模块	说明	受影响的器件修订版本
		B
ADC	公告 ADC_08 - 在重复单次，序列和重复序列转换模式下不会清除 ADC 繁忙位	是
BATMON	公告 BATMON_01 - 温度测量不正确	是
BATMON	公共 BATMON_02 - 待机时来自 BATMON 的虚假温度更新中断	是
SYS	公告 SYS_204 - 在之前使用某个值进行编程时，SysTimer 可能并不总是会生成比较事件	是
SYS	公告 SYS_206 - HFXT 振幅补偿和 HFXT 振幅控制期间的射频相位跳变	是
SYS	公告 SYS_207 - 如果 FLTSETTLED 位读取时间太短，则可能无法对待机进入进行门控	是
UDMA	公告 UDMA_01 - 可能会丢失对外设的单个请求的 μ DMA 写入响应	是

2 命名规则、封装编号法和修订版本标识

2.1 器件和开发支持 - 工具命名规则

为了标示产品开发周期所处的阶段，德州仪器 (TI)™ 为所有 SimpleLink 无线设备的器件型号分配了前缀。每个 SimpleLink 无线器件型号都具有以下两种前缀之一：CC 或 XC。这些前缀代表了产品开发的发展阶段，即从工程原型 (XC) 直到完全合格的生产器件 (CC)。

器件开发进化流程：

XC 试验器件不一定代表最终器件的电气规格，并且可能不使用生产封装流程。

CC 完全合格的器件芯片量产版本。

X 器件在供货时附带如下免责声明：

“开发中的产品用于内部评估用途。”

生产器件已进行完全特性化，并且器件的质量和可靠性已经完全论证。TI 的标准保修证书对该器件适用。

预测显示原型器件 (X) 的故障率大于标准生产器件。由于这些器件的预期最终使用故障率仍未确定，德州仪器 (TI) 建议不要将这些器件用于任何生产系统。请仅使用合格的生产器件。

2.2 支持的器件

本文档支持以下器件：

- CC2755P207E0WRHAR

2.3 封装编号法和修订版本标识

封装符号 和 表 2-1 介绍了封装编号法和器件修订版代码。

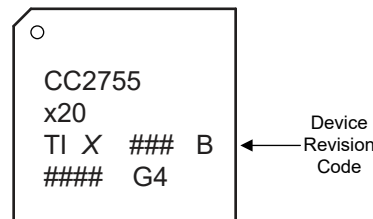


图 2-1. 封装符号

表 2-1. 版本标识

器件修订版本代码	硅片版本
B	PG1.1

器件标识包括器件型号 CC2755x，其中 x 表示器件的功率级别。##### 是批次追踪代码。TI 字母后的选择性“X”表示实验器件。G4 是环境分类。

3 公告

ADC_08

在重复单次、序列和重复序列转换模式下，ADC 繁忙位不会被清除。

受影响版本

B

说明

当 ADC 在 MEMCTLx 寄存器中配置为重复单次、序列或重复序列转换模式且触发策略为“触发下一个”时，尝试通过清零 ENC 位来停止转换序列的软件不会清除 STATUS 寄存器中的 BUSY 位。对于具有触发下一个策略的序列转换模式，BUSY 位在转换序列结束时清零。

权变措施

在上述 ADC 操作场景中，若要停止转换并清除 BUSY 位，可以执行以下软件序列。

1. 写入 CTL0.ENC = 0
2. 将 CTL1.TRIGSRC 更改为 SOFTWARE
3. 写入 CTL1.SC=1

BATMON_01	温度测量值不正确
受影响版本	B
说明	启用迟滞时，BATMON 可以报告不正确的温度。为了防止报告的温度可能不正确，用户必须始终禁用 BATMON 迟滞。
权变措施	迟滞由 PMUD.CLT[2] HYST_EN 位控制。 默认启用迟滞（复位值= 1），因此必须在启动期间主动禁用迟滞。 可以使用以下命令清除 PMUD.CLT[2] HYST_EN 位来禁用迟滞： <pre>HWREG(PMUD_BASE + PMUD_O_CTL) = (PMUD_CTL_CALC_EN PMUD_CTL_MEAS_EN)</pre> 此权变措施已集成到 SimpleLink™ 低功耗 F3 软件开发套件 (SDK) 版本 9.11 和更高版本中。

BATMON_02	待机时 BATMON 产生虚假温度更新中断。
受影响版本	B
说明	当 PMUD.EVENT.TEMP_UPDATE 用作从待机状态唤醒源时，BATMON 可能会发出虚假温度更新中断。
权变措施	不使用 PMUD.EVENT.TEMP_UPDATE 作为唤醒源，而是考虑 PMUD.EVENT.TEMP_OVER_UL (当前温度超过设定的上限) 或 PMUD.EVENT.TEMP_BELOW_LL (当前温度低于设定的下限)。 当使用 PMUD.EVENT.TEMP_OVER_UL 或 PMUD.EVENT.TEMP_BELOW_LL 作为唤醒中断时，必须启用的其他设置，包括： • 通过将 PMCTL.VDDRCTL.SELECT 设置为 0x0，选择 GLDO 作为 VDDR 调节的源。 备注 这会导致待机功耗略有增加。有关确切的详细信息，请查看数据表的“功耗 - 电源模式”部分。 • 将 SYS0.TMUTE4.RECHCOMPREFLVL 设为 0x2。 • 将 SYS0.TMUTE5.GLDOISSET 设为 0x1E。 此权变措施可集成到 SimpleLink™ 低功耗 F3 软件开发套件 (SDK) 的未来版本中。

SYS_204	当之前使用某个值进行编程时， SysTimer 可能并不总是会生成比较事件。
受影响版本	B
说明	当 SysTimer 之前已经使用一个值进行编程时， SysTimer 在初始化/同步递增阶段并不总是会生成比较事件。
权变措施	等待对 SysTimer 进行编程，直到 SYSTIM.STATUS.SYNCUP 被清除。此权变措施已集成到 SimpleLink™ 低功耗 F3 软件开发套件 (SDK) 版本 9.11 和更高版本中。

SYS_206	HFXT 振幅补偿和 HFXT 振幅控制期间的射频相位跳变。
受影响版本	B
说明	HFXT 振幅补偿和 HFXT 振幅控制期间的射频相位跳变。此问题仅在器件完成启动后才适用，然后在使用 HFXT 时通过编程方式调整电容器阵列值。如果在启动期间设置了电容器阵列值，则不会出现此问题。
权变措施	只能在启动期间和任何射频操作之前设置或修改电容器阵列步骤。在该时间点后，请勿在运行时动态修改 CAP 数组步骤。可以在 SysConfig 中修改 Q1 和 Q2 电容器阵列步骤。

SYS_207

如果 **FLTSETTLED** 位被读取得太早，则可能不会选通待机进入。

受影响版本

B

说明

如果在 **LFINC** 滤波器稳定之前尝试，则可能不会选通待机进入，并且读取时间太短。使用 **LFXT** 时不会出现此问题。

权变措施

为了解决此问题，在使用 **LFOSC** 时请执行以下操作：

- 1.同时清除两个中断。
- 2.检查是否存在 **CKMD.RIS.HFXTGOOD**。
- 3.请检查是否存在 **CKMD.RIS.LFTICK**。
- 4.检查是否存在 **FLTSETTLED**。

仅当 **LFINC** 滤波器稳定时才应触发待机进入，这可以通过读取存储器屏蔽寄存器 (**MMR**) **CKMD.LFCLKSTAT.FLTSETTLED** 位来确认。

或者，可以使用 **LFXT**，并且可以避免这种情况。此权变措施已集成到 **SimpleLink™** 低功耗 **F3** 软件开发套件 (**SDK**) 版本 **9.11** 和更高版本中。

UDMA_01

对外设的单个 μ DMA 的写入响应可能会丢失。

受影响版本

B

详细信息

μ DMA 可响应外设的单次请求和猝发请求。如果由于仲裁丢失而导致互连写缓冲器截获了来自 μ DMA 的写入访问，则外设可能会产生第二个虚假单次或突发请求。由于 μ DMA 会在外设的 FIFO 中较早的写入缓冲区内容填满后响应第二个请求，因此外设会忽略第二个写入，因此错过第二个写入。仅在通过 μ DMA TX 通道进行数据传输期间才会出现此问题。由于通过互连的读取路径不包括写入缓冲器，因此 μ DMA RX 通道上不会出现该问题。

权变措施

μ DMA SETBURST 被配置为使用猝发请求。

μ DMA 仲裁数目为 2。

TX FIFO 级别触发器设置为 $\leq 1/4$ 空。

此权变措施已集成到 SimpleLink™ 低功耗 F3 软件开发套件 (SDK) 版本 9.11 和更高版本中。

重要通知和免责声明

TI“按原样”提供技术和可靠性数据（包括数据表）、设计资源（包括参考设计）、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源，不保证没有瑕疵且不做任何明示或暗示的担保，包括但不限于对适销性、与某特定用途的适用性或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。

这些资源可供使用 TI 产品进行设计的熟练开发人员使用。您将自行承担以下全部责任：(1) 针对您的应用选择合适的 TI 产品，(2) 设计、验证并测试您的应用，(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他安全、安保法规或其他要求。

这些资源如有变更，恕不另行通知。TI 授权您仅可将这些资源用于研发本资源所述的 TI 产品的相关应用。严禁以其他方式对这些资源进行复制或展示。您无权使用任何其他 TI 知识产权或任何第三方知识产权。对于因您对这些资源的使用而对 TI 及其代表造成的任何索赔、损害、成本、损失和债务，您将全额赔偿，TI 对此概不负责。

TI 提供的产品受 [TI 销售条款](#)、[TI 通用质量指南](#) 或 [ti.com](#) 上其他适用条款或 TI 产品随附的其他适用条款的约束。TI 提供这些资源并不会扩展或以其他方式更改 TI 针对 TI 产品发布的适用的担保或担保免责声明。除非德州仪器 (TI) 明确将某产品指定为定制产品或客户特定产品，否则其产品均为按确定价格收入目录的标准通用器件。

TI 反对并拒绝您可能提出的任何其他或不同的条款。

版权所有 © 2026，德州仪器 (TI) 公司

最后更新日期：2025 年 10 月